特集/エレクトロニクス実装技術の現状と展望

システムインテグレーション実装技術を牽引しはじめ 第**2**ステージに入ったファン・アウト・パッケージと これを支える材料

Fan-Out Package that Has Entered the Second Stage Started Leading the System Integration Assembly Technology and Materials to Support This

システムインテグレーション実装技術委員会